



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > PCI 和 PCI Express 连接器



连接器系统: 缆到板

端子接合区域电镀材料厚度: [ 15 µin ]

位数: 98

PCI 世代: 2 & 3

中心线（间距）: 1 mm [.039 in]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 连接器系统     | 缆到板   |

结构特性

|              |    |
|--------------|----|
| PCB 安装固定特性数量 | 2  |
| 位数           | 98 |
| PCB 安装方向     | 垂直 |
| 弹射器          | 不带 |

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 50 VAC |
|------|--------|

主体特性

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 产品重量   | 5.45 g[.192 oz] |
| 主要产品颜色 | 黑色              |

接触件特性

|                  |         |
|------------------|---------|
| 端子额定电流（最大值）      | 1.1 A   |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 2.54 µm |
| 端子接触部电镀材料        | 镀金      |
| 端子基材             | 磷青铜     |
| PCB 端子端接区域电镀材料   | 锡       |



|                    |        |
|--------------------|--------|
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光     |
|                    | 15 µin |

端接特性

|            |                 |
|------------|-----------------|
| PCB 端接方法   | 通孔 - 焊接         |
| 端接柱体和尾部长度的 | 3.1 mm[.122 in] |

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 外壳材料    | PA 9T GF      |
| 中心线（间距） | 1 mm[.039 in] |

尺寸

|             |                  |
|-------------|------------------|
| PCB 厚度（建议）  | 2.39 mm[.094 in] |
| PCB 厚度（已接受） | 1.57 mm[.062 in] |
| 连接器长度       | 56 mm[2.205 in]  |
| 连接器高度       | 10 mm[.394 in]   |
| 连接器宽度       | 8.8 mm[.346 in]  |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

行业标准

|        |             |
|--------|-------------|
| 总线类型   | PCI Express |
| PCI 世代 | 2 & 3       |

包装特性

|      |            |
|------|------------|
| 封装方法 | Tray, 盒和托盘 |
| 封装数量 | 40         |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月  
(241)  
不含REACH SVHC

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。 |
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 265°C                 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-2337939-4  
PCIe GEN4 CON,SMT,164POS,30u",MYLAR,HT

TE 产品编号 1734774-1  
PCI EXP 3.1L 36 POS WHT G/F

客户还购买了

TE 产品编号292206-3  
MINI CT SGL DIP H 3P NAT

TE 产品编号2-292207-3  
MINI CT SGL DIP V 3P BLACK

TE 产品编号2-292207-9  
MINI CT SGL DIP V 9P BLACK

TE 产品编号3-292207-2  
MINI CT SGL DIP V 12P BLACK

TE 产品编号3-292207-9  
MINI CT SGL DIP V 19P BLACK

TE 产品编号292251-3  
CT P/HDR BOX V 3P POL NAT

TE 产品编号8-292129-3  
SGL HDR ASSY BOX DIP H W/KINK

TE 产品编号8-292129-4  
SGL HDR ASSY BOX DIP H W/KINK



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1734774-1\_F.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1734774-1\_F.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1734774-1\_F.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本